

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4256  
जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है।  
05 चैत्र, 1947 (शक)

**आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का विस्तार**

**4256 श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को स्वीकृत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परियोजनाओं का ब्यौरा बापतला में नियोजित परियोजनाओं सहित क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (फैब) इकाइयों, चिप डिजाइन केंद्रों या इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों (ईएमसी) की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;
- (ग) इन पहलों के माध्यम से राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं; और
- (घ) मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सेमीकंडक्टर उत्पादन में निजी निवेश आकर्षित करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) और (घ) :** सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परियोजना के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो निम्नलिखित प्रदान करता है:

- i. भारत में सिलिकॉन पूरक मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) आधारित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% समान आधार पर राजकोषीय समर्थन।
- ii. भारत में डिस्ले फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन।
- iii. भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम सहित) फैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के 50% की राजकोषीय सहायता।
- iv. प्रोडक्ट लिंकड इन्सेंटिव पात्र व्यय के 50% तक होगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, चिप डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति आवेदन 30 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार के 6% से 4% तक का "डिप्लोयमेंट लिंकड इन्सेंटिव" भी दिया जाएगा।

सरकारनेमोहालीस्थितसेमीकंडक्टरप्रयोगशालाकेआधुनिकीकरणकोभीमंजूरीदेदीहै। इसकेअलावा,  
सेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासमेंसहयोगकेलिएसिंगापुर, अमेरिका,  
यूरोपीयसंघऔरजापानकेसाथसमझौताज्ञापनपरहस्ताक्षरकिएगएहैं।

सेमीकॉनडुक्टाकार्यक्रमकेतहतसरकारनेलगभग 1,52,000 करोड़रुपएकेसंचयीनिवेशकेसाथपाँच (5)  
सेमीकंडक्टरविनिर्माणपरियोजनाओंकोमंजूरीदीहै। इसकेअलावा,  
भारतीयउत्पादोंकेलिएचिप्सडिजाइनकरनेकेलिएडिजाइनलिंकडिसेंटिवस्कीमकेतहत 17  
सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकोमंजूरीदीगईहै। इसकेअतिरिक्त,  
इसयोजनाकेतहतउपलब्धकराएगईडीएउपकरणोंतकपहुँचकेलिए 64  
सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकोमंजूरीदीगईहै।

इसकेअलावा, चिप्सट्रस्टार्ट-अप (सी2एस) कार्यक्रमसेमीकंडक्टरचिपडिजाइन, वीएलएसआई  
(बहुतबड़ेपैमानेपरएकीकरण) औरएम्बेडेडसिस्टमडिजाइनक्षेत्रोंमेंविशेषज्ञतावाले 85,000 उद्योग-  
तैयारजनशक्तितैयारकरनेकेलिएशुरूकियागयाएकव्यापककार्यक्रमहै। सी2एसकार्यक्रमकेतहत, आंध्रप्रदेश  
(आ०प्र०) राज्यमें 4 आरएंडडी परियोजनाओंकोमंजूरीदीगईहै। इसकेअलावा, इसकार्यक्रमकेतहतआ०प्र०राज्यके  
12 संस्थानोंकोईडीएउपकरणोंतकपहुँचप्रदानकीगईहै।

सेमीकॉनडुक्टाकार्यक्रमसेअतिरिक्तसरकारनेकईयोजनाएंशुरूकीहैं,  
जैसेबड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेलिएप्रोडक्ट लिंकडि इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना,  
आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआई, इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरयोजना,  
इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमीकंडक्टरोंकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस)  
औरसंशोधितविशेषप्रोत्साहनपैकेजयोजना (एम-एसआईपीएस),  
ताकिदेशमेंक्षमताओंकोप्रोत्साहितऔरबढ़ावादेकरभारतकोइलेक्ट्रॉनिक्ससिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण  
(ईएसडीएम) केलिएवैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापितकियाजासके।

इनपहलोकेंअंतर्गत, आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईकेअंतर्गत 27 कंपनियां (आंध्रप्रदेशमें 1 सहित),  
पीएलआईबड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेअंतर्गत 32 कंपनियां (आंध्रप्रदेशमें 2 सहित),  
इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरयोजनाकेअंतर्गत 28 क्लस्टरऔर 4 सामान्यसुविधाकेंद्र (सीएफसी) (आंध्रप्रदेशमें 4  
सहित), एमएसआईपीएसकेअंतर्गत 313 कंपनियां (आंध्रप्रदेशमें 9 सहित) कोमंजूरीदीगईहै।

(ख) : सरकारने 76,000  
करोड़रुपएकेकुलपरिव्ययकेसाथसेमीकॉनडुक्टाकार्यक्रमकोमंजूरीदीहैजिसमेंडिजाइनलिंकडिसेंटिव  
(डीएलआई) योजनाकेलिए 1,000 करोड़रुपएकापरिव्ययशामिलहै; जिसमेंसे 60,000  
करोड़रुपएसेअधिककीराशि 5  
सेमीकंडक्टरविनिर्माणपरियोजनाओंकेलिएपहलेहीप्रतिबद्धकीजाचुकीहैऔरडीएलआईकेतहतस्वीकृत 17  
सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकेलिए 200 करोड़रुपएसेअधिककीराशिप्रतिबद्धकीगईहै।  
इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचना प्रौद्योगिकीमंत्रालयकीइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरयोजनाओंकाकुलपरिव्यय 5,232  
करोड़रुपएहैजिसमेंसेलगभग 3,400 करोड़रुपएविभिन्नराज्योंमेंईएमसीकेलिएप्रतिबद्धहैं।

(ग) : इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएविभिन्नयोजनाओंकेतहतस्वीकृतउपरोक्तकंपनियोंनेपहलेही 6  
लाखसेअधिकरोजगारकेअवसरपैदाकिएहैं। इसकेअलावा, स्वीकृत 5  
सेमीकंडक्टरविनिर्माणपरियोजनाओंसेफैक्ट्रीऑटोमेशनकीपरिपक्वताकेआधारपर 26,000  
सेअधिकप्रत्यक्षरोजगारकेअवसरपैदाहोनेकीउम्मीदहै।  
इनइकाइयोंसेअन्यक्षेत्रोंऔरआपूर्तिशृंखलामेंरोजगारसृजनपरव्यापकप्रभावपड़नेकीउम्मीदहै।

\*\*\*\*\*